

2024-2030年中国芯片行业发展运行现状及投资战略规划报告

报告大纲

一、报告简介

华经情报网发布的《2024-2030年中国芯片行业发展运行现状及投资战略规划报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.huaon.com/channel/jingpin/electric/934530.html>

报告价格：电子版: 9000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

本研究报告数据主要采用国家统计局数据、海关总署、问卷调查数据、商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 芯片行业的总体概述

1.1 基本概念

1.2 制作过程

1.2.1 原料晶圆

1.2.2 晶圆涂膜

1.2.3 光刻显影

1.2.4 掺杂杂质

1.2.5 晶圆测试

1.2.6 芯片封装

1.2.7 测试包装

第二章 2019-2023年全球芯片产业发展分析

2.1 2019-2023年世界芯片市场综述

2.1.1 市场特点分析

2.1.2 全球发展形势

2.1.3 全球市场规模

2.1.4 市场竞争格局

2.2 美国

2.3 日本

2.4 韩国

2.5 印度

2.6 其他国家芯片产业发展分析

2.6.1 英国

2.6.2 德国

2.6.3 瑞士

第三章 中国芯片产业发展环境分析

3.1 政策环境

3.1.1 智能制造政策

3.1.2 集成电路政策

3.1.3 半导体产业规划

3.1.4 “互联网+”政策

3.2 经济环境

3.2.1 国民经济运行状况

3.2.2 工业经济增长情况

3.2.3 固定资产投资情况

3.2.4 经济转型升级形势

3.2.5 宏观经济发展趋势

3.3 社会环境

3.3.1 互联网加速发展

3.3.2 智能产品的普及

3.3.3 科技人才队伍壮大

3.4 技术环境

3.4.1 技术研发进展

3.4.2 无线芯片技术

3.4.3 技术发展趋势

第四章 2019-2023年中国芯片产业发展分析

4.1 中国芯片行业发展综述

4.1.1 产业发展历程

4.1.2 全球发展地位

4.1.3 海外投资标的

4.2 2019-2023年中国芯片市场格局分析

4.2.1 市场规模现状

4.2.2 市场竞争格局

4.2.3 行业利润流向

4.2.4 市场发展动态

4.3 2019-2023年中国量子芯片发展进程

4.3.1 产品发展历程

4.3.2 市场发展形势

4.3.3 产品研发动态

4.3.4 未来发展前景

4.4 2019-2023年芯片产业区域发展动态

4.4.1 湖南

4.4.2 贵州

4.4.3 北京

4.4.4 晋江

4.5 中国芯片产业发展问题分析

4.5.1 产业发展困境

4.5.2 开发速度放缓

4.5.3 市场垄断困境

4.6 中国芯片产业应对策略分析

4.6.1 企业发展战略

4.6.2 突破垄断策略

4.6.3 加强技术研发

第五章 2019-2023年中国芯片产业上游市场发展分析

5.1 2019-2023年中国半导体产业发展分析

5.1.1 行业发展意义

5.1.2 产业政策环境

5.1.3 市场规模现状

5.1.4 产业资金投资

5.1.5 市场前景分析

5.1.6 未来发展方向

5.2 2019-2023年中国芯片设计行业发展分析

5.2.1 产业发展历程

5.2.2 市场发展现状

5.2.3 市场竞争格局

5.2.4 企业专利情况

5.2.5 国内外差距分析

5.3 2019-2023年中国晶圆代工产业发展分析

5.3.1 晶圆加工技术

5.3.2 国外发展模式

5.3.3 国内发展模式

5.3.4 企业竞争现状

5.3.5 市场布局分析

5.3.6 产业面临挑战

第六章 芯片设计行业重点企业经营分析

6.1 高通公司

6.1.1 企业发展概况

6.1.2 经营效益分析

6.1.3 新品研发进展

6.2 博通有限公司（原安华高科技）

6.2.1 企业发展概况

6.2.2 经营效益分析

6.2.3 新品研发进展

6.3 英伟达

6.3.1 企业发展概况

6.3.2 经营效益分析

6.3.3 新品研发进展

6.4 AMD

6.4.1 企业发展概况

6.4.2 经营效益分析

6.4.3 新品研发进展

6.5 Marvell

6.5.1 企业发展概况

6.5.2 经营效益分析

6.5.3 新品研发进展

6.6 赛灵思

6.6.1 企业发展概况

6.6.2 经营效益分析

6.6.3 新品研发进展

6.7 Altera

6.7.1 企业发展概况

6.7.2 经营效益分析

6.7.3 新品研发进展

6.8 Cirrus logic

6.8.1 企业发展概况

6.8.2 经营效益分析

6.8.3 新品研发进展

6.9 联发科

6.9.1 企业发展概况

6.9.2 经营效益分析

6.9.3 新品研发进展

6.10 展讯

6.10.1 企业发展概况

6.10.2 经营效益分析

6.10.3 新品研发进展

第七章 晶圆代工行业重点企业经营分析

7.1 格罗方德

7.1.1 企业发展概况

7.1.2 经营效益分析

7.1.3 企业发展形势

7.2 三星

7.2.1 企业发展概况

7.2.2 经营效益分析

7.2.3 企业发展形势

7.3 Tower jazz

7.3.1 企业发展概况

7.3.2 经营效益分析

7.3.3 企业发展形势

7.4 富士通

7.4.1 企业发展概况

7.4.2 经营效益分析

7.4.3 企业发展形势

7.5 台积电

7.5.1 企业发展概况

7.5.2 经营效益分析

7.5.3 企业发展形势

7.6 联电

7.6.1 企业发展概况

7.6.2 经营效益分析

7.6.3 企业发展形势

7.7 力晶

7.7.1 企业发展概况

7.7.2 经营效益分析

7.7.3 企业发展形势

7.8 中芯

7.8.1 企业发展概况

7.8.2 经营效益分析

7.8.3 企业发展形势

7.9 华虹

7.9.1 企业发展概况

7.9.2 经营效益分析

7.9.3 企业发展形势

第八章 2019-2023年中国芯片产业中游市场发展分析

8.1 2019-2023年中国芯片封装行业发展分析

8.1.1 封装技术介绍

8.1.2 市场发展现状

8.1.3 国内竞争格局

8.1.4 技术发展趋势

8.2 2019-2023年中国芯片测试行业发展分析

8.2.1 IC测试原理

8.2.2 测试准备规划

8.2.3 主要测试分类

8.2.4 发展面临的问题

8.3 中国芯片封测行业发展方向分析

8.3.1 承接产业链转移

8.3.2 集中度持续提升

8.3.3 国产化进程加快

8.3.4 产业短板补齐升级

8.3.5 加速淘汰落后产能

第九章 芯片封装测试行业重点企业经营分析

9.1 Amkor

9.1.1 企业发展概况

9.1.2 经营效益分析

9.1.3 业务经营分析

9.2 日月光

9.2.1 企业发展概况

9.2.2 经营效益分析

9.2.3 业务经营分析

9.3 矽品

9.3.1 企业发展概况

9.3.2 经营效益分析

9.3.3 业务经营分析

9.4 南茂

9.4.1 企业发展概况

9.4.2 经营效益分析

9.4.3 业务经营分析

9.5 颀邦

9.5.1 企业发展概况

9.5.2 经营效益分析

9.5.3 业务经营分析

9.6 长电科技

9.6.1 企业发展概况

9.6.2 经营效益分析

9.6.3 业务经营分析

9.7 天水华天

9.7.1 企业发展概况

9.7.2 经营效益分析

9.7.3 业务经营分析

9.8 通富微电

9.8.1 企业发展概况

9.8.2 经营效益分析

9.8.3 业务经营分析

9.9 士兰微

9.9.1 企业发展概况

9.9.2 经营效益分析

9.9.3 业务经营分析

第十章 2019-2023年中国芯片产业下游应用市场发展分析

10.1 LED

- 10.1.1 全球市场规模
- 10.1.2 LED芯片厂商
- 10.1.3 主要企业布局
- 10.1.4 封装技术难点
- 10.1.5 LED产业趋势
- 10.2 物联网
 - 10.2.1 产业链的地位
 - 10.2.2 市场发展现状
 - 10.2.3 物联网wifi芯片
 - 10.2.4 国产化的困境
 - 10.2.5 产业发展困境
- 10.3 无人机
 - 10.3.1 全球市场规模
 - 10.3.2 市场竞争格局
 - 10.3.3 主流主控芯片
 - 10.3.4 芯片重点应用领域
 - 10.3.5 市场前景分析
- 10.4 北斗系统
- 10.5 智能穿戴
- 10.6 智能手机
- 10.7 汽车电子
- 10.8 生物医药

第十一章 2019-2023年中国集成电路产业发展分析

- 11.1 中国集成电路行业总况分析
 - 11.1.1 国内市场崛起
 - 11.1.2 产业政策推动
 - 11.1.3 主要应用市场
 - 11.1.4 产业增长形势
- 11.2 2019-2023年集成电路市场规模分析
 - 11.2.1 全球市场规模
 - 11.2.2 市场规模现状
 - 11.2.3 市场供需分析
 - 11.2.4 产业链的规模
 - 11.2.5 外贸规模分析

11.3 2019-2023年中国集成电路市场竞争格局

11.3.1 进入壁垒提高

11.3.2 上游垄断加剧

11.3.3 内部竞争激烈

11.4 中国集成电路产业发展的问题及对策

11.4.1 发展面临问题

11.4.2 发展对策分析

11.4.3 产业突破方向

11.4.4 “十四五”发展建议

11.5 集成电路行业未来发展趋势及潜力分析

11.5.1 全球市场趋势

11.5.2 国内行业趋势

11.5.3 行业机遇分析

11.5.4 市场规模预测

第十二章 中国芯片行业投资分析

12.1 行业投资现状

12.1.1 全球产业并购

12.1.2 国内并购现状

12.1.3 重点投资领域

12.2 产业并购动态

12.2.1 ARM

12.2.2 Intel

12.2.3 NXP

12.2.4 Dialog

12.2.5 Avago

12.2.6 长电科技

12.2.7 紫光股份

12.2.8 Microsemi

12.2.9 Western Digital

12.2.10 ON Semiconductor

12.3 投资风险分析

12.3.1 宏观经济风险

12.3.2 环保相关风险

12.3.3 产业结构性风险

12.4 融资策略分析

12.4.1 项目包装融资

12.4.2 高新技术融资

12.4.3 BOT项目融资

12.4.4 IFC国际融资

12.4.5 专项资金融资

第十三章 中国芯片产业未来前景展望

13.1 中国芯片市场发展机遇分析

13.1.1 市场机遇分析

13.1.2 国内市场前景

13.1.3 产业发展趋势

13.2 中国芯片产业细分领域前景展望

13.2.1 芯片材料

13.2.2 芯片设计

13.2.3 芯片制造

13.2.4 芯片封测

图表目录：

图表1 2019-2023年全球半导体市场销售规模

图表2 2019-2023年全球芯片销售规模

图表3 2023年全球IC公司市场占有率

图表4 2023年欧洲IC设计公司销售规模

图表5 2019-2023年美国半导体行业从业人员规模变动情况

图表6 2019-2023年人类每秒每\$1000成本所得到的计算能力增长曲线

图表7 28nm单个晶体管历史成本

图表8 日本综合电机企业的半导体业务重组

图表9 东芝公司半导体事业改革框架

图表10 智能制造系统架构

更多图表见正文.....

详细请访问：<https://www.huaon.com/channel/jingpin/electric/934530.html>